

Versatile Format Interconnect (VFI) 光バックプレーンシステム

プラグアンドプレイのモジュール式高速Versatile Format Interconnect (VFI) 光バックプレーンシステムは、次世代のデータセンターとコンピューティングアーキテクチャのためのコパッケージドオプティクスとスケーラブルなシステム拡大をサポートします。汎用性の高いフォームファクターと堅牢なブラインド嵌合の機械設計は、複数のフォームファクターとの互換性をサポートし、高まり続けるAI主導の容量需要への対応に役立つシンプルで信頼性に優れた光接続ソリューションを提供します。

利点と特徴

拡張性を効率化してアップグレードを簡素化

1x2、1x4、1x6、および1x8オプションを含めた複数のMTフェルール構成は、設計を最適化し、進化する性能要求を満たすための柔軟性を提供します。

設置作業を簡素化してダウンタイムを低減

ブラインド嵌合型のホットスワップ可能な設計によって3軸すべてに十分な機械的フロートが確保されるため、銅線システムから光システムへの切り替えが容易になります。

相互運用性と高ファイバー密度を実現

業界標準のMTフェルールインターフェースは、フェルールあたり最大36のファイバーと任意のMTフェルールベースフットプリントとの互換性を実現する優れた光性能を提供し、統合時の課題を最小限に抑えます。ケーブルアセンブリーは、標準のリボンファイバーまたはFlexPlaneアセンブリーに終端接続することで設計上の制約を軽減します。

市場と用途

ネットワーク

コパッケージドオプティクス
スイッチ

サーバーとストレージ

コパッケージドオプティクス
ハイパースケーラ
機械学習システム

電気通信

ハイパフォーマンスコンピューティングのシステム

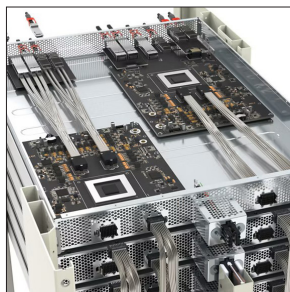
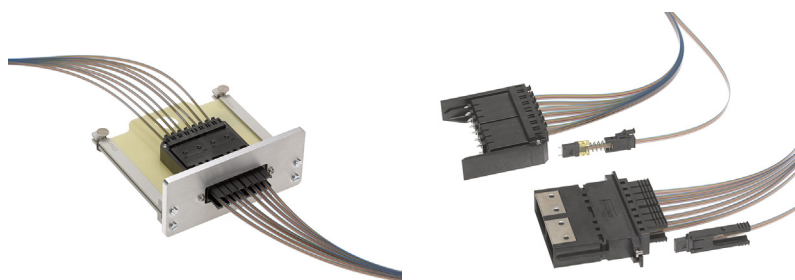
フェルールタイプ	MTまたはVersaBeam MT
ポート構成 (MTフェルール)	1x2、1x4、1x6、1x8
ファイバー数 (MTフェルール)	フェルールあたり8、12、24、または36ファイバー
ファイバーモード	シングルモード、マルチモード

コパッケージド光接続を可能にすることで配線の混雑や複雑性を排除

コンパクトなフォームファクターと高速機能によってチップ直結型の光接続が可能になるため、フロントパネルまたはリアパネルからの多心光接続をサポートできます。

保守要件を低減

非接触型フェルールインターフェースを使用するMTマイクロレンズアレイは、ゴミが原因で発生する問題を最小限に抑え、エアブラスト洗浄を容易にし、ダウンタイムを低減します。



コパッケージドオプティクス



ハイパフォーマンス
コンピューティングのシステム



スイッチ

Versatile Format Interconnect (VFI) 光バックプレーンシステム

仕様

参考情報

梱包：個別バック、ピニール袋

設計単位：ミリメートル

RoHS：はい

ハロゲンフリー：はい

ULファイル番号：94V-0素材を活用

嵌合対象：VFIドーターカードはVFIバックプレーン
アダプターと嵌合

使用対象：シングルモード、マルチモードMT

VersaBeam MTマルチモードコネクタおよび

ケーブルアセンブリ

ファイバーモード：シングルモード、マルチモード

光学的仕様

挿入ロス：フェルルタイプに依存

リターンロス：フェルルタイプに依存

機械的仕様

フェルルタイプ：MTまたはVersaBeam MT

ファイバー数：フェルルあたり8、12、24、または
36ファイバー

アダプターポートオプション：1x2、1x4、1x6、1x8

バネ圧：

12ファイバーMT – フェルルあたり10N

VersaBeam MT – フェルルあたり5N

耐久性（最小値）：嵌合サイクル50回

物理的仕様

ハウジング：ポリマー

フェルル：

MT – ガラス繊維強化ポリフェニレンスルフィド

VersaBeam MT – 光学グレードのプラスチック

動作温度：-20~+70°C